

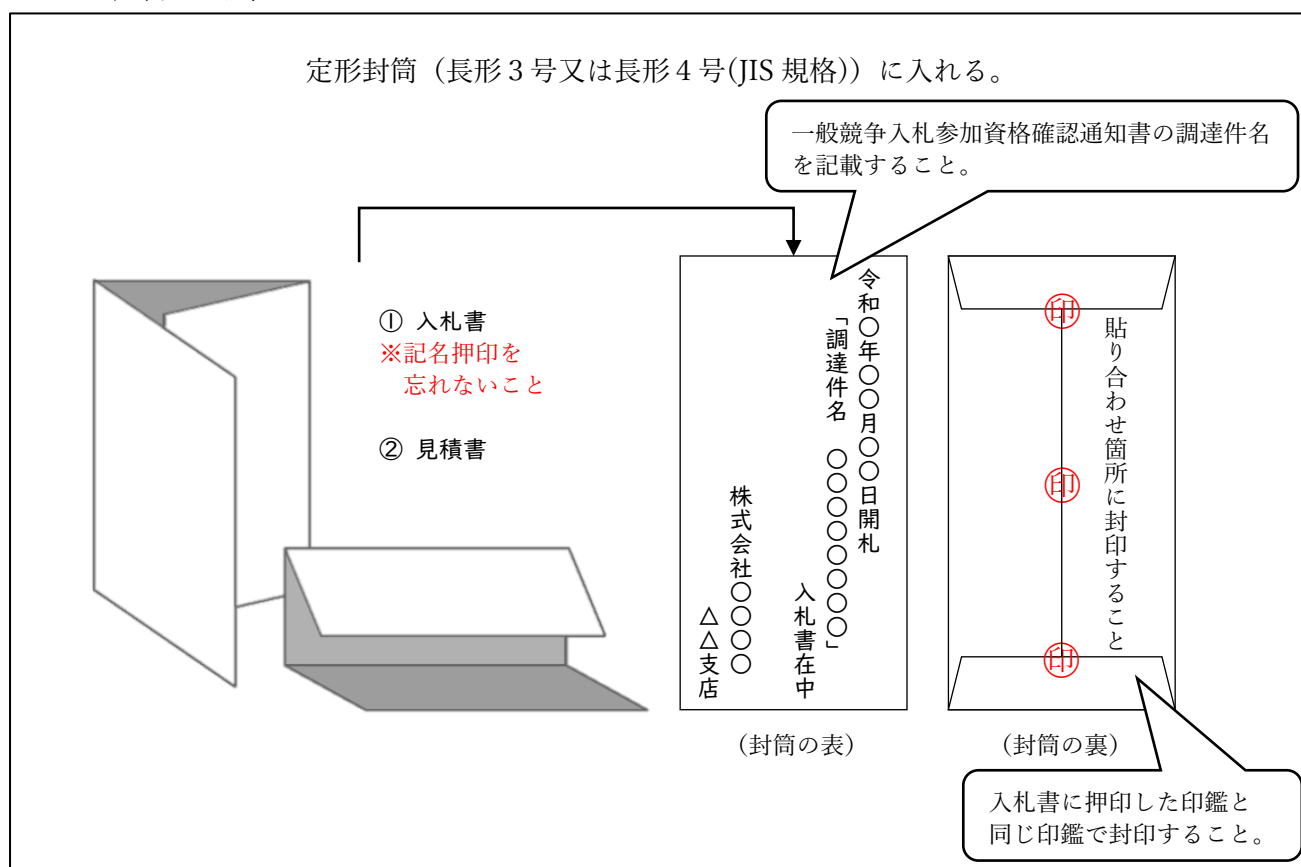
入札書等郵送方法

郵送により入札に参加するときは、次に掲げる書類を入札公告に定める提出期間内に配達証明付一般書留郵便により、学校法人自治医科大学 総務部 情報システム課あてに親展で郵送しなければならない。

- ① 入札書
 - ② 見積書
 - ③ 技術評価表
 - ④ 技術提案書
 - ⑤ 監査人の要件を証するものの写し（仕様書「6 監査人の要件」参照）
 - ⑥ 入札参加表明書（原本）
 - ⑦ 一般競争入札参加資格確認通知書（写）
- ※原本を定形封筒に入れて封印すること。

郵送・封印に当たっての具体的な方法は、以下の図を参照して次の1から2の順に封印等を行わなければならない。

1 入札書の封印



2 入札書（封印済）の封入



- ③ 技術評価表
- ④ 技術提案書
- ⑤ 監査人の要件を証するものの写し
- ⑥ 入札参加表明書（原本）
- ⑦ 一般競争入札参加資格確認通知書（写）

令和〇年〇〇月〇〇日開札
「調達件名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」
入札書在中
株式会社〇〇〇〇
△△支店

（封印したもの）

↓
郵送用の封筒に入れる。

329-0498

栃木県下野市薬師寺三三一番一号
学校法人 自治医科大学
総務部 情報システム課 行

親展
令和〇年〇〇月〇〇日開札
「調達件名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」
入札書在中

朱書きすること

（封筒の表）

貼り合わせ箇所封印すること

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目
株式会社〇〇〇〇
△△支店
TEL 〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇〇

（封筒の裏）

入札書に押印した印鑑と
同じ印鑑で封印すること。